

特点

- 电流：5-300A，电压100-1600V
- 小型通用尺寸“真空+充氧保护”焊接技术
- 玻璃钝化二极芯片
- 优秀的力量/体积比率，高热的传导封装

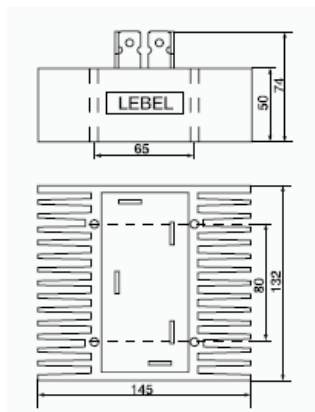
典型应用

- 整流电源，工业自动化控制
- 数控机床，遥控系统

$I_{F(AV)}$	150-300A
V_{RRM}	100-1600V
V_F	1.1V
I_{FSM}	400A

符号	参数	测试条件	参数值			单位
			最小	典型	最大	
$I_{F(AV)}$	正向平均电流	180° 正弦半波，50HZ 双面散热，THS=55°C	150		300	A
V_{RRM}	反向重复峰值电压	$V_{DRM}&V_{RRM} tp=10ms$ $V_{DSM}&V_{RSM}=V_{DRM}&V_{RRM}+100$	100		1600	V
V_{RMS}	平均方根电压		70		860	V
V_{DC}	直流阻断电压		100		1600	V
I_{FSM}	正向不重复浪涌电流	正弦半波			400	A
V_F	二极管的正向电压	$I_F=17.5A$			1.1	V
I_R	反向漏电流	$T_a=25^\circ C$			10	μA
$I_{R(H)}$		$T_a=100^\circ C$			200	μA
$R_{th(j-c)}$	热阻抗（结至壳）	180° 正弦波，单面散热			5.0	$^\circ C/W$
$R_{th(c-a)}$	热阻抗（壳至环）	180° 正弦波，单面散热			8	$^\circ C/W$
V_{iso}	绝缘电压		2500			V
T_J	工作温度		-40		125	$^\circ C$
T_{stq}	储存温度		-40		150	$^\circ C$
W_t	质量			1200		g
Outline	外形					

外形图：



线路图：

